

【Characteristics】 Solder resist is missing on an iron-base printed board in the form of a foreign object once existed. The exposed area is often rusted.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布時に鉄板面に介在した異物が、S R 塗布を妨げ、かつ S R 乾燥後に剥離したことにより出来たもの（S R 塗布～乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 SR 涂布时，铁基板面夹杂杂物，妨碍 SR 涂布，而且 SR 烘干后剥落所引起的（SR 涂布～干燥后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A foreign object existing on an iron-base printed board at the time of solder resist application prevents solder resist coating and the object is peeled off after curing, causing the defect. (Solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×

2-2-2-2 異物剥離部 SR 不付き／杂物剥落部位的 SR 不粘結 / Solder resist missing at a peeled foreign object

【特徴】 S R が異物形状どおりについでいない状態の欠陥

【特征】 SR 像杂物形状那样不沾着的缺陷

【Characteristics】 Solder resist does not coat over an iron base board not exactly in the form of a foreign object once existed.

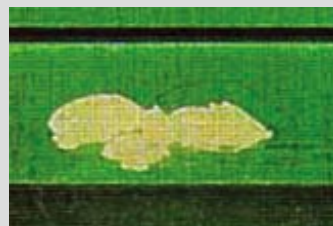
【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布時に板面に介在した異物が、S R 塗布を妨げ、かつ S R 乾燥後に剥離したことにより出来たもの（S R 塗布～乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 板面夹杂的杂物妨碍 SR 涂布，并且在烘干后剥落而引起的（涂布 SR ～烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A foreign object existing on a board at the time of solder resist application prevents solder resist coating and is partially peeled off after solder resist curing, causing the defect. (Solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率× 40
【注釋】
显微镜倍率× 40
【Comments】
Magnification: ×40

2-2-2-3 PSR 未露光部不付き／PSR 未曝光部位的剥落 / Photo solder resist missing caused by a foreign object

【特徴】 P S R が異物形状どおりについでいない状態の欠陥